

GWSM-300R1

ウェーハ / 支持基板剥離装置

【概要 - Outline -】

◆本装置は、B/G工程の前装置としてウェーハ薄厚化に対応する為、予め特殊両面テープが貼付けられたウェーハと支持基板を真空状態内において貼り合わせを行う装置である。



仕様 Specification	GWSM-300R1
スループット Throughput	10 ~ 15 枚/h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)
対応ウェーハサイズ Wafer Size	8・12 inch
装置寸法 Demension	W 910 × D 1,500 × H 1,750 mm
重量 Weight	約 400 kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.